



2022年10月13日

各位

会社名 藤森工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 布山英士
(コード番号 7917 東証プライム市場)
問合せ先 取締役 上席執行役員 管理部門管掌
佐藤道彦
TEL. 03-5804-4221

電子部材事業強化のための設備投資に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、生産設備の増設等を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 設備投資の理由

当社は電子部材事業拡大に向け、半導体周辺部材の開発・生産拠点である群馬県の沼田事業所及び昭和事業所に総額 130 億円の設備投資を行います。着工は 2023 年を予定。既存設備の改造により 2024 年から随時生産能力を拡張、さらに新規精密塗工機の稼働によって、2026 年には現行の約 3 倍の生産能力となる予定です。

この投資により下記 3 点の実現を図ってまいります。

- ・世界的な需要が高まる、半導体パッケージ用層間絶縁材料「味の素ビルドアップフィルム®」(ABF) の増産対応
- ・半導体市場全体の成長を支える、精密コーティングサービスの強化
- ・未来の超スマート社会に求められる、大容量高速通信を実現する次世代製品の開発

2. 設備投資の内容

(1) 設置事業所	沼田事業所（群馬県沼田市町田町） 昭和事業所（群馬県利根郡昭和村）
(2) 投資内容	既存設備の改造、新規精密塗工機の導入 ハイクリーン管理、スマート化、環境に配慮した生産体制の構築
(3) 投資総額	約 130 億円（予定）
(4) 生産開始	2024 年から随時（予定）

当社は、来る超スマート社会に向け、5G による次世代高速通信を実現する半導体周辺の部材開発に取り組んでおります。また、電子部材業界で 30 年以上の実績を重ねてきた精密コーティングサービスを通して培った塗加工技術、ハイクリーンな環境管理体制を常にアップデートしてきました。半導体関連市場は CAGR 約 9% (2020-2030)と推定され、特に、データセンターのサーバー向け及び通信ネットワーク向けの半導体パッケージ基板の基幹材料として業界標準になっている、味の素ファインテック株式会社様の ABF の需要も伸長すると見込まれています(CAGR 約 18%)^{※1}。業界全体で高まる技術・品質への要求へ応えると共に、グローバル市場の追い風をとらえた事業成長の機会として、本投資を決定しました。この投資により、半導体周辺部材の生産能力は約 3 倍となる見込みです。既存設備の改造及び新規精密塗工機の導入だけでなく、ハイクリーン環境での生産管理、スマート化及び環境に配慮した生産体制を構築しながら、電子部材事業の拡大に取り組んでまいります。

なお、当社情報電子事業の取り組みは下記ウェブサイトをご参照ください。
藤森工業 情報電子事業本部製品サイト:<https://electronics.zacros.co.jp>

※1：味の素株式会社推計 ABF 出荷数量見込み（2020-2025）

3. 今後の見通し

本件における当期業績に与える影響は軽微であります。今後の設備導入の進捗状況等により、業績に与える影響が発生すると判断した場合には、速やかに開示をさせていただきます。

以 上